

各 位

2006年3月28日
日本特殊陶業株式会社
取締役社長 加藤倫朗

ICパッケージ/酸素センサ生産工場建設の件

当社は、半導体ICパッケージおよび酸素センサの増産を目的として、下記の通り工場建設を決定しましたのでその概要をお知らせ致します。

記

1. ICパッケージ生産工場

工場建設に至る背景：

パソコン需要の急増に伴い、半導体関連の客先からの強い増産要請に対応するため、現小牧工場敷地内に新たに工場建屋の建設を決定いたしました。

新工場名称：日本特殊陶業(株) 小牧第14工場

所在地：愛知県小牧市大字岩崎2808（弊社小牧工場敷地内）

生産品目：半導体ICパッケージ

構造・規模：鉄骨造5階建 160m×80m

建築面積（延床面積）：約54千㎡

投資額：約300億円

着工予定：2006年5月

竣工予定：2007年6月

2. 酸素センサ生産工場

工場建設に至る背景：

自動車業界の好調を背景に酸素センサの需要は順調に増加しており、生産能力増強を目的として現在の酸素センサ主力工場であるセラミックセンサ(株)第2工場の増築を決定いたしました。

工場名称：セラミックセンサ(株) 第2工場増築

所在地：愛知県小牧市大字横内字中横内391-5（セラミックセンサ(株)敷地内）

生産品目：酸素センサ

構造・規模：鉄骨造5階建 52.5m×48m

建築面積（延床面積）：約12.3千㎡

投資額：約56億円

着工予定：2006年6月

竣工予定：2007年3月

以 上

(お問い合わせ先)

総務部広報課 加藤正史

T E L 052-872-5896